# STB 受託加工サービス

## 裏面研削+ポリッシュCMP ダイシング

トレイ詰め

## 外観検査

STB

Visual Inspection

Back Grinding+Polish CMP

Dicing

Pellet charge

#### 受託加工サービス内容

Service 1 裏面研削 (BG) +ポリッシュCMP: Siウェハ

Service 2 ダイシング: Siウェハ、膜付ガラス、セラミックス等

Service **3** トレイ詰め Service **4** 外観検査



#### 裏面研削+ポリッシュCMP

フラットなウェハ以外も、はんだBUMP形成後のパターン面に凹凸のあるウェハにも 100umt前後の薄残し研削が可能。

量産では100umt、試作では100umt以下の薄仕上げにも対応。 ご要望に合わせてBG研削による破砕層をポリッシュ加工でストレスリリーフ致します。



## ダイシング

1枚からお受けします。実験、試作、量産も対応可能です。

加工実績:Si、SiC、ガラス、FR-4等の樹脂、

セラミック基板、Si on Glassの様な複合材、また経験の無い素材も試作致します。

多角形の加工や、マルチパターン(シャトルチップ)の対応、

お客様立会いテスト加工も可能です。



### トレイ詰め

ダイシング済みのチップをご指定のトレイ等へ移載して、良品のみのチップ梱包が可能。 インチ対応のチップトレイ、JEDECトレイ、エンボステープへのウェハからの詰め替えや、 カスタムサイズのトレイにも対応いたします。



## 外観検査

お客様の仕様に併せて全数検査、抜き取り検査、ウェハ状態での検査等を致します。

実体顕微鏡、金属顕微鏡使用 検査倍率:15~200倍 チップの抗折強度の評価・確認が可能です。(最大荷重100N)

\*ニュートン、グラム、メガパスカルでのデータ出力が可能です。

厚さ測定(接触式)ウェハ状態からチップの厚さまで、測定可能です。 (0.001umまでの測定可能)

チップの抗折強度の評価・確認が可能です。 (最大荷重 100N)

粗さ測定(接触式)ウェハ裏面研削後の面粗さ状態の確認が可能です。 (Ra≥0.001以上 測定が可能)

\*Ra、Rz、Ry、Rmax、Sm、S、tpなど出力パラメーターは全部で34種類。









#### ケメット・ジャパン株式会社

Shine the Innovation

#### お問合せ先

ケメット・ジャパン株式会社 東京青梅工場 MAT事業部 〒198-0171東京都青梅市二俣尾3丁目841番地 1 TEL:0428-78-8402 FAX: 0428-78-9773

info@kemet.jp





# STB 受託加工サービス



## 裏面研削+ポリッシュCMP ダイシング

#### トレイ詰め

外観検査

Back Grinding+Polish CMP

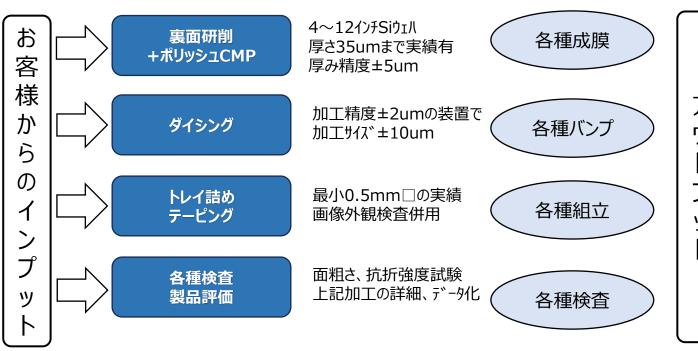
Dicing

Pellet charge

Visual Inspection

### お客様の「やりたいこと」を実現します!

### どのようなご要望工程へも1枚から量産までのインプット可能です



主なダイシング実績素材

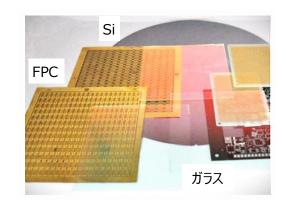
Si、各種ガラス、FR-4等基板、セラミックス、 ポリイミド基板、WLCSP、アクリル板等樹脂 複合材(Si+ガラス等)

実績無しの素材でも試作を行います

ダイシング 加工例









## ケメット・ジャパン株式会社

Shine the Innovation

他にもこんな特徴があります!

- ✓ 半導体前工程のCMP受託加工サービスもございます
- 独自の加工レシピを所有
- ✓ BG・CMP・ダイシングの自社ワンストップサービス(東京青梅工場にて)

ア ウ プ v